

2025 年 6 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ
代表者名 代表執行役社長 CEO 明間 純
(コード番号 6740 東証プライム)
問合せ先 執行役員 CFO 平林 健
(TEL. 03-6732-8100)

(開示事項の変更) PanelSemi Corporation (台湾) との資本業務提携に関するお知らせ

当社は、2025 年 2 月 12 日付「先端半導体パッケージング及びセンサー技術を手掛ける PanelSemi Corporation (台湾) との資本業務提携のお知らせ」にて、PanelSemi Corporation (台湾、以下「PanelSemi」といいます。) との間で、JDI による出資契約及び今後の協業に関する覚書 (MOU) を締結したこと (以下、これらを合わせて「本資本業務提携」といいます。) を発表いたしました。このたび、両社の協議の結果、出資契約の実行は見送ることとするものの、協業については今後も継続することで合意いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本資本業務提携の変更の理由

近時の半導体分野を取り巻く地政学的リスクのさらなる高まりや、グローバル経済環境の急激な変化を踏まえ、資本提携のスキームを再検討する必要があるとの認識で両社が一致し、出資契約について、現時点では実行を見送ることいたしました。また、MOU には出資契約と連動する条項が含まれていることから、出資契約の実行見送りに伴い、MOU についても両社合意のもと終了することいたしました。

なお、先端半導体パッケージング用基板の開発及びセンサー事業の推進については、今後も個別の合意に基づき、両社間での協業を継続してまいります。その一例として、本日付プレスリリース「JPCA Show 2025 にて先端半導体パッケージング基板を出展ー世界トップクラスのガラス基板加工技術をセラミック基板に活用した高精細 RDLー」のとおり、両社は 2025 年 6 月 4 日～6 日に東京ビッグサイトで開催される「JPCA Show 2025 国際電子回路産業展」において、セラミック基板上に高精細 RDL (Re-Distribution Layer) 配線を形成したサンプルを共同展示いたします。

2. 業績に与える影響

本資本業務提携の変更が 2026 年 3 月期の業績に与える影響は軽微です。

なお、当社は現在、2026 年 3 月期の連結業績予想を開示しておりません。

以 上